

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1347)

**須予披露交易
向中信銀行認購結構性存款產品**

茲提述本公司日期為二零一八年八月二十四日之公告（「該公告」），內容有關自二零一八年四月二十四日至二零一八年八月二十四日期間內認購多間銀行銷售之若干金融產品。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有該公告所指定之涵義。

如該公告所披露，華虹無錫先前已於二零一八年四月二十五日、二零一八年五月九日、二零一八年七月十二日及二零一八年八月十日分別認購中信銀行（無錫分行）銷售之本金額為人民幣480,000,000元、人民幣100,000,000元、人民幣1,020,000,000元及人民幣480,000,000元之若干金融產品。

董事會欣然宣佈，於二零一八年八月二十七日，華虹無錫已與中信銀行（無錫分行）額外訂立一份結構性存款產品協議（「第三份中信結構性存款產品協議」）。

與中信銀行之認購事項

第三份中信結構性存款產品協議

第三份中信結構性存款產品協議之主要條款概要載列如下：

產品名稱	:	共贏利率結構21551期人民幣結構性存款產品
日期	:	二零一八年八月二十七日
訂約方	:	華虹無錫（作為認購方）與中信銀行（無錫分行）（作為銀行）
收益類型	:	保本浮動收益型
本金額	:	人民幣100,000,000元
期限	:	自二零一八年八月二十七日開始及於二零一八年十二月十三日屆滿，為期108天
預期年收益率	:	介於4.2%至4.7%之間（倘於二零一八年十二月十一日倫敦時間上午十一時正3個月美元倫敦銀行間同業拆放利率低於或等於8.00%，則預期年收益率將為4.2%；倘於二零一八年十二月十一日倫敦時間上午十一時正3個月美元倫敦銀行間同業拆放利率高於8.00%，則預期年收益率將為4.7%）
投資範圍	:	該產品為結構性產品，其全部資金透過結構性利率掉期方式進行投資運作
提前終止	:	華虹無錫無權於到期日前撤回任何本金

認購金融產品之理由及裨益

本公司認為，第三份中信結構性存款產品協議下銷售之金融產品將為中信銀行發行之保本、短期及低風險投資產品，可提供較銀行或持牌金融機構現時提供定期存款利率更為優厚之利率。董事認為，認購該金融產品將可有效利用華虹無錫所持現金，並獲得安全及有吸引力的回報。因此，董事認為，認購該金融產品符合一般商業條款及屬公平合理，並符合本集團及其股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於若干金融產品乃與中信銀行訂立且性質類似，故與中信銀行之認購事項及第三份中信結構性存款產品協議下之交易將根據上市規則第14.22條於計算相關百分比率時合併計算及處理，猶如本公司與中信銀行之一項交易。由於與中信銀行之認購事項及第三份中信結構性存款產品協議下之交易按合併基準計算之適用百分比率超過5%但低於25%，該等交易構成本公司之須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章之申報及公告規定。與中信銀行之認購事項之詳情已於該公告內披露。

有關訂約方之資料

本公司

本公司為特種應用之半導體（主要為8英寸(200mm)晶圓）製造商。本公司之技術，尤其是嵌入式非易失性存儲器(eNVM)及功率器件，主要應用於消費者電子、通訊、計算及工業以及汽車行業。

華虹無錫

華虹無錫目前為本公司之非全資子公司。其業務為從事12英寸(300mm)晶圓集成電路之設計、研究、製造、測試、封裝及銷售。

中信銀行

中信銀行前稱中信實業銀行，於一九八七年成立並於二零零五年底改為現名。中信銀行為中國的全國性商業銀行之一，總部位於北京，主要股東為中國中信股份有限公司。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，中信銀行及其最終實益擁有人為獨立於本集團及其關連人士之第三方。

承董事會命
華虹半導體有限公司
張素心先生
董事長兼執行董事

中國上海，二零一八年八月二十七日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事

張素心 (董事長)

王煜 (總裁)

非執行董事

陳劍波

馬玉川

森田隆之

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壘，太平紳士

葉龍蜚